

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

公告编号：2026-055

债券代码：123267

债券简称：珂玛转债

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	珂玛科技	股票代码	301611
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	仇劲松	雷梦思	
电话	0512-68088521	0512-68088521	
办公地址	江苏省苏州市高新区新钱路 1 号	江苏省苏州市高新区新钱路 1 号	
电子信箱	jerry.qiu@kematek.com	m.lei@kematek.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	592,213,616.61	520,397,584.40	13.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,247,047.71	171,863,893.38	-42.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,389,156.09	170,547,488.82	-43.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,214,837.38	141,159,612.29	-73.64%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.39	-41.03%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.39	-43.59%
加权平均净资产收益率	5.35%	10.70%	-5.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	3,539,516,097.12	2,613,142,474.85	35.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,892,160,817.78	1,776,824,889.80	6.49%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘先兵	境内自然人	44.19%	192,649,465	192,649,465	不适用	0
胡文	境内自然人	16.67%	72,676,450	72,676,450	不适用	0
苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.65%	15,925,314	15,925,314	不适用	0
苏州市博璨企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	6,126,729	6,126,729	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	4,582,880	0	不适用	0
刘俊	境内自然人	0.94%	4,094,497	0	不适用	0
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	3,302,784	0	不适用	0
北京诺华资本投资管理有限公司－北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）	其他	0.69%	3,020,275	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	0.65%	2,829,887	0	不适用	0
高建	境内自然人	0.61%	2,648,509	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘先兵持有苏州博盈 16.24%的财产份额并担任执行事务合伙人，直接持有苏州博璨 0.71%的财产份额并担任执行事务合伙人；高建持有苏州博盈 19.21%的财产份额；除上述情况之外，未知上述股东相互之间是否存在关联关系或一致行动					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 ☐不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
珂玛转债	珂玛转债	123267	2026 年 04 月 16 日	2032 年 04 月 15 日	70,423.17	第一年 0.10% 第二年 0.30% 第三年 0.60% 第四年 1.00% 第五年 1.50% 第六年 2.00%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：人民币万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	46.61%	31.75%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	10.81	375.18

三、重要事项

1、公司所处行业发展情况

先进陶瓷是在多个国民经济重要领域中发挥着重要作用的关键基础材料。陶瓷材料具备优良材料特性，与金属材料、高分子材料并列为当代“三大固体材料”。按照材料成分，先进陶瓷主要分为氧化物、氮化物和碳化物陶瓷等；按照用途，先进陶瓷可分为主要具有强机械性能、耐腐蚀等理化特性的结构陶瓷和具有电、磁等特性的功能陶瓷。

全球先进陶瓷发展历史悠久，研发与工业化生产已经有超过 100 年的历史。中国先进陶瓷市场起步较晚，根据弗若斯特沙利文数据，2015 年中国先进结构陶瓷国产化率仅约 5%，到 2023 年已提高至约 25%，半导体、锂电池行业多项关键先进陶瓷材料零部件产品不同程度上实现了国产替代。根据弗若斯特沙利文数据，2026 年全球泛半导体先进结构陶瓷市场规模预计达到 514 亿元（包括新购、零部件换新两方面需求），中国泛半导体先进结构陶瓷市场规模预计将达到 125 亿元。尽管如此，国内晶圆厂所使用制造设备的先进结构陶瓷零部件国产化水平仍然较低，尤其主要用于半导体晶圆制造环节薄膜沉积设备和刻蚀设备的陶瓷加热器和静电卡盘，国内设备厂商和晶圆厂商仍然主要依赖境外采购以满足新设备的生产需求以及老设备的零部件替换需求。

全球半导体市场规模和半导体制造设备支出显示出极其强劲的增长态势，这主要是由于 AI、云基础设施、先进消费电子产品等领域的持续海量需求所带动。根据 WSTS 数据，2026 年上半年全球半导体市场规模已达到 7,020 亿美元，同比大幅增长 102%。同时，根据 SEMI 数据，2026 年全球半导体制造设备销售额预计将达到 1,659 亿美元，较 2025 年同比增长 23.2%。

在我国大力扶持半导体产业的背景下，全球半导体及上游零部件全产业链产能向中国大陆转移，在国产化背景趋势下，预计未来中国大陆半导体领域市场需求在阶段性波动恢复后将继续保持平稳较快增长。中国大陆仍然稳居全球半导体设备支出龙头，根据 SEMI 数据，2025 年度中国大陆半导体设备销售额达到 493 亿美元。根据 Bernstein 竞争格局报告，2025 年中国大陆半导体设备国产化率从 2024 年的 16% 跃升至 21%。半导体设备在成熟制程领域国产化已取得显著进展，但先进制程领域的高端设备仍需突破“卡脖子”环节，未来国产替代空间广阔。

虽然国产半导体设备中结构陶瓷部件国产化率不断提升，但是来自日本、美国、韩国的供应商在不同细分市场和技术领域保持领先地位，尤其在半导体设备关键部件“功能-结构”模块类产品方面，例如陶瓷加热器、静电卡盘以及超高纯碳化硅套件等，通常为全球半导体设备厂商和晶圆厂商的首选供应商，包括国内半导体设备厂商和晶圆厂商。对于国内半导体设备厂商来说，陶瓷加热器、静电卡盘以及超高纯碳化硅套件等“功能-结构”模块类关键部件上，亟需国内零部件厂商填补国产空白，在产业化和国产替代方面取得实质性进展；对于国内晶圆厂商来说，大量进口半导体设备里的先进陶瓷材料零部件，包括陶瓷加热器和静电卡盘等，需要定期更换，由于存在被原厂断供或限购的风险，晶圆厂商也不得不寻找替代方案。当然国家政策支持力度加大，行业内企业不断突破关键技术，以及国内相关产业链日益完善，这些因素都推动我国半导体设备先进结构陶瓷市场的迅猛发展。

2、公司主营业务

公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。先进陶瓷材料是采用高度精选或合成的原料，具有精确控制的化学组成，并且具有特定的精细结构和优异性能的陶瓷材料。公司是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一，掌握关键的材料配方与加工工艺，并具备先进陶瓷前道制造、硬脆难加工材料加工和新品表面处理等全工艺流程技术。公司目前拥有由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钪和氧化钛 6 大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系，主要类型材料的耐腐蚀、电绝缘、高导热、强机械性能等性能已达到国际主流客户的严格标准。

3、公司主要产品及服务

（1）先进陶瓷材料零部件

公司先进陶瓷业务的基础是材料，产品形式是高度定制化的零部件，最终端应用于半导体、新能源等多个国民经济重要行业。目前已量产氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钪和氧化钛 6 大类材料先进陶瓷材料，累计设计开发了一万余款定制化零部件。

公司先进陶瓷材料零部件应用于多个领域，按领域区分的产品情况如下：

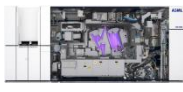
(i) 半导体领域

半导体设备零部件是公司报告期内先进陶瓷产品的最主要应用。半导体设备是半导体产业的基础支撑，其中前道工艺主要完成晶圆制造，该等工艺设备类型繁杂，技术难度较高。半导体设备由腔室内和腔室外组成，陶瓷大部分用在更接近晶圆的腔室内，其技术要求严苛，须在先进陶瓷材料性能、硬脆难加工材料精密加工及新品表面处理等方面满足客户要求。

公司先进陶瓷主要应用于晶圆制造前道工艺设备，目前已进入刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻和氧化扩散等多种设备，是国内半导体设备用先进陶瓷材料零部件的头部企业。公司客户覆盖国际头部半导体设备厂商 A 公司，主流国产半导体设备厂商包括北方华创、中微公司、拓荆科技、上海微电子和芯源微等，以及国内晶圆厂商。

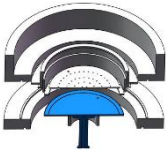
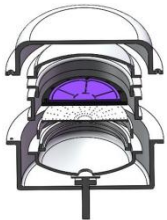
公司用于半导体设备的先进陶瓷材料零部件产品主要应用于腔室内，其中部分零部件直接与晶圆接触，是集成电路制造中关键的精密零部件，包括圆环圆筒、气流导向、承重固定和手爪垫片等结构件产品，以及陶瓷加热器、静电卡盘以及超高纯碳化硅套件等高难度“功能-结构”一体模块化产品。

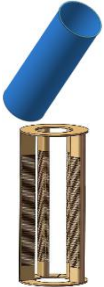
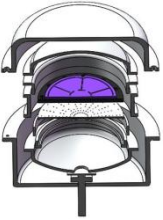
分不同工艺流程及对应半导体设备，公司先进陶瓷材料零部件产品的应用情况如下：

工艺流程			刻蚀	薄膜沉积	离子注入	光刻及相关的涂胶显影	氧化/扩散、退火、合金等
应用公司产品的前道设备			刻蚀机	PVD、CVD 和 ALD 设备	离子注入设备	光刻机、涂胶显影设备	氧化扩散设备
设备图示							
公司产品	结构件类产品	产品类型	圆环圆筒类、气流导向类、承重固定类、手爪垫片类、真空吸盘	圆环圆筒类、气流导向类、承重固定类、手爪垫片类	圆环圆筒类、承重固定类、手爪垫片类	承重固定类、手爪垫片类	承重固定类、手爪垫片类
		材料类型	氧化铝、氮化铝、碳化硅	氧化铝、氮化铝、碳化硅	氧化铝、氮化铝	氧化铝、碳化硅	氧化铝、氮化铝、碳化硅
	“功能-结构”一体模块化产品	产品类型	静电卡盘	陶瓷加热器、静电卡盘	-	-	陶瓷加热器、超高纯碳化硅套件
		材料类型	氧化铝	氧化铝、氮化铝	-	-	氮化铝、碳化硅
公司代表性客户			A 公司、北方华创、中微公司、长光华芯	A 公司、WATLOW、北方华创、中微公司、拓荆科技、Q 公司	上海华力微	H 公司、科益虹源、芯源微	北方华创
公司产品主要材料种类			氧化铝、氮化铝、碳化硅	氧化铝、氮化铝、碳化硅	氧化铝、氮化铝	氧化铝、碳化硅	氧化铝

公司在半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氮化铝零部件等“卡脖子”产品方面实现了国产替代，多项关键技术指标达到国内领先、国际主流水平。同时，公司亦是目前国内少数有多种陶瓷材料和产品通过国际头部半导体设备厂商 A 公司认证且被其批量采购的先进结构陶瓷企业之一。

此外，公司从 2016 年承接国家“02 专项”课题起，不断完善核心材料配方并攻克了多项复杂工艺，是国内较早切入“功能-结构”一体模块化产品研发、客户验证并批量生产的企业。公司目前主要“功能-结构”一体模块化产品研发和产业化进展如下：

产品名称	产品应用设备图	产品图示	适用半导体设备	功能	全球主要供应商	产业化进展		
						客户拓展	累计出货量	累计开发款式
陶瓷加热器			薄膜沉积设备（具体包括 CVD、PVD、ALD 设备）、激光退火设备	薄膜沉积工艺过程中，均匀加热硅片，使构造稳定的沉积工艺环境，对晶圆质量和制造良率起关键作用	日本碍子全球份额超过 50%	(1) 供应北方华创、中微公司、拓荆科技、O 公司、P 公司和华卓精科等； (2) 在 Q 公司生产中大批量应用	截至 2026 年 6 月末，已累计生产并交付超过 2,000 多支	6 英寸、8 英寸各已开发 2 款产品，12 英寸已开发 43 款产品
静电卡盘			刻蚀机、部分薄膜沉积设备	通过静电吸附硅片，并吸引等离子体完成刻蚀工艺。	日本特殊陶业是全球第一大供应商，其他供应商包括京瓷集团等	(1) 8 英寸刻蚀机 Monopolar 静电卡盘已经通过 B 公司验证并小规模量产； (2) 12 英寸 ICP/CCP 刻蚀机 Monopolar 静电卡盘已通过 B 公司验证并小规模量产，多区加热静电卡盘已初步通过验证	截至 2026 年 6 月末，持续小批量出货	8 英寸和 12 英寸静电卡盘已完成验证并实现小规模量产，12 寸多区加热静电卡盘已成功完成开发

产品名称	产品应用设备图	产品图示	适用半导体设备	功能	全球主要供应商	产业化进展		
						客户拓展	累计出货量	累计开发款式
超高纯碳化硅套件			氧化扩散设备、部分薄膜沉积设备	通过精确控制温度、气体氛围、反应时间，使硅材料发生化学反应或物理变化，从而形成集成电路所需的晶体结构和电学性能	CoorsTek 是全球第一大供应商，市场份额超过 80%，日本旭硝子全球份额为 10~20%	(1) 6 英寸重结晶套件通过北方华创及 Fab 端验证并小批量供应； (2) 8 英寸重结晶套件通过北方华创验证，正在 Fab 端推广； (3) 12 英寸渗硅套件部分部件，例如 Cap、隔热片等已通过北方华创验证并小批量供应，其他部件例如晶舟等尚在验证中	截至 2026 年 6 月末，已小批量出货	6 英寸已开发 1 款全套产品，8 英寸已开发 2 款全套产品，12 英寸全套中部分部件已验证通过并少量生产，部分正在开发验证中
CVD 碳化硅部件			刻蚀机	协同控制腔内的气流、电场与等离子体，共同保障晶圆表面的高均匀性刻蚀	东海碳是全球第一大供应商，市场份额超过 60%	12 英寸 ICP/CCP 刻蚀机部件多款产品已通过北方华创、中微公司验证	截至 2026 年 6 月末，已小批量出货	12 英寸 ICP/CCP 刻蚀机部件已分别开发多款

(ii) 泛半导体领域

在显示面板制造、LED 制造及光伏制造等方面，公司已量产用于刻蚀、PVD、CVD 设备和工艺连接器等的先进陶瓷材料零部件。

(iii) 其他领域

在电子（包括锂电池）材料粉体粉碎和分级领域，公司主要生产砂磨机涡轮、分级机分级轮、三辊机轧辊等先进陶瓷材料零部件，凭借高硬度、高韧性特点，它们被使用在多种粉体粉碎和分级设备上，作为核心零部件，发挥研磨、击碎、摩擦、分离和筛选等关键功能。公司作为国内本土企业的代表实现了关键零部件如“分级轮”的国产化，“分级轮”产品的最大运转线速度超过 60m/s，分级粒度可达到 1 μ m，上述两项关键性能指标均已达到全球主流水平。

此外，在汽车制造领域，公司主要生产氧化锆、氧化铝材质的焊装销和定位销等产品，焊装销被用在中高端汽车的生产焊接设备，起到高温、火花保护等功能，定位销被用在汽车的装配过程中，起到定位的功能；在纺织领域，公司针对不同纱线类型调整材料配方并设计晶粒规格，改变先进陶瓷表面粗糙度等表面结构，发挥引导及保护纱线的功能；在生物医药领域，生物医药中药剂注射、灌装等工序设备对零部件的耐腐蚀性要求高，公司已生产并销售用于高压均质机的陶瓷棒、隔离套等生物医药设备零部件产品。

(2) 表面处理服务

公司表面处理服务面向显示面板制造厂和设备制造原厂，主要为显示面板工艺设备零部件提供清洗和再生改造服务。通过精密清洗、阳极氧化和熔射等主要手段，以洗净再生、熔射再生等综合解决方案为先进陶瓷、石英、金属等多种类型的设备零部件进行阶段性污染物控制，提高部件耐腐蚀性等性能，以保障显示面板制造工艺稳定、提高大规模制造良率。公司服务于多家全球知名显示面板制造企业，具备较强的综合服务能力，在表面处理的洁净度、耐用性等关键指标上客户反馈良好，赢得了较高的市场声誉。

表面处理还是先进陶瓷材料零部件新品制造的重要后道工序之一。公司采用精密清洗严格量化控制表面颗粒物、金属离子等污染物，并采用喷砂和熔射等形成特定表面涂层和形貌。这些特殊工艺能力也属于先进陶瓷材料产品生产的核心技术。

4、公司主要业绩驱动因素

公司主营业务收入主要为先进陶瓷材料零部件销售收入、其他材料零部件销售收入以及泛半导体设备表面处理服务收入，收入规模逐年增长，合计占营业收入的比例在 99%以上，公司主营业务突出。其他业务收入主要为零部件加工服务收入及贸易业务收入等，占营业收入的比重较小。

(1) 先进陶瓷材料零部件

公司在 2026 年上半年及 2025 年同期先进陶瓷材料零部件的营业收入分别为 54,342.99 万元和 47,742.92 万元，2026 年上半年比去年同期增长 13.82%。

先进陶瓷材料零部件的下游主要应用领域包括半导体、泛半导体、粉体粉碎和分级等领域，各领域收入规模及占比情况具体如下：

单位：人民币万元

应用领域	产品	2026 年上半年		2025 年上半年	
		金额	占比	金额	占比
半导体领域	结构件产品	30,649.20	56.40%	27,925.50	58.49%
	“功能-结构”一体模块化产品	17,222.06	31.69%	15,803.06	33.10%
泛半导体领域		844.31	1.55%	1,723.88	3.61%
粉体粉碎和分级领域		2,410.98	4.44%	1,374.43	2.88%
其他领域		3,216.44	5.92%	916.05	1.92%
合计		54,342.99	100.00%	47,742.92	100.00%

半导体领域是公司产品的主要应用方向，公司在 2026 年上半年及 2025 年同期来自半导体领域的先进陶瓷材料零部件收入分别为 47,871.26 万元和 43,728.56 万元，占先进陶瓷材料零部件收入的比例分别为 88.09%和 91.59%，2026 年上半年比去年同期增长 9.47%。

2026 年上半年，受益于国内半导体产能的持续扩张以及设备国产替代进程的稳步深化，下游半导体设备客户的核心采购需求稳健释放，采购订单有序交付转化，带动先进陶瓷材料结构件产品销售收入扎实增长。半导体领域结构件产品，2026 年上半年销售收入为 30,649.20 万元，比去年同期增长 9.75%。

2026 年上半年，半导体领域收入的增加也来源于公司“功能-结构”一体模块化产品的持续大规模量产交付。基于多年技术积累、研发及产业化布局，公司半导体设备核心部件陶瓷加热器实现国产替代，该“功能-结构”一体模块化产品解决了半导体晶圆厂商 CVD 设备关键零部件的“卡脖子”问题。公司为国内半导体晶圆厂商和半导体设备厂商研发生产并销售多款陶瓷加热器产品，装配于 SACVD、PECVD、LPCVD 和激光退火等设备，部分陶瓷加热器产品已量产并大量应用于晶圆的薄膜沉积生产工艺流程。公司在 2026 年继续着力于陶瓷加热器的性能优化及产品迭代，借助先进生产基地项目在 2025 年初投产的优势，优化工艺流程，持续推动产品向客户的稳定交付。同时，静电卡盘与超高纯碳化硅套件也逐步完成验证并开始小批量交付，形成了一定的收入。半导体领域“功能-结构”一体模块化产品，2026 年上半年销售收入为 17,222.06 万元，比去年同期增长 8.98%。

2026 年上半年，受泛半导体产业周期性调整影响，显示面板、LED 和光伏等领域的下游客户阶段性放缓了新增设备的投资节奏，公司来自显示面板、LED 和光伏等其他泛半导体的结构件产品的收入下降幅度较大；国内新能源领域经过前期调整，行业景气度已逐步筑底企稳，受益于下游终端产能需求的修复，相关产品订单稳步释放，故公司粉体粉碎和分级领域收入在 2026 年上半年增长幅度较大。

公司先进陶瓷材料零部件应用的其他领域包括能源环保、汽车生产、纺织和生物医药等领域，2026 年上半年销售收入较去年同期大幅增长 251.12%，主要系控股子公司安徽珂玛在碳化硅辊棒、换热管等产品上积极拓展业务，并形成了规模化销售。

（2）表面处理服务

公司表面处理服务包括熔射再生服务和洗净再生服务，下游均面向泛半导体领域，在 2026 年上半年及 2025 年同期收入分别为 2,766.83 万元和 3,747.35 万元，收入较去年同期有所回落，主要受下游显示面板行业排产节奏阶段性优化的影响，一定程度上拉长了面板制造设备相关工艺零部件的维护更新周期，导致表面处理服务需求出现阶段性减少。长期来看，随着面板行业盈利水平的修复，表面处理业务的市场需求预计仍将保持平稳韧性。

（3）其他材料零部件

公司在 2026 年上半年及 2025 年同期其他材料零部件产品收入分别为 1,628.34 万元和 254.53 万元，呈增长趋势。其他材料零部件主要包括金属零部件、石墨零部件和 CVD 碳化硅涂层零部件，其中金属零部件主要产品包括上部电极、壁板等，主要用于显示面板生产设备；石墨零部件和 CVD 碳化硅涂层零部件系苏州铠欣业务，在 2025 年 7 月公司完成对苏州铠欣的并购后，其销售收入助力了其他材料零部件收入规模的增长。